

## PIC 扇出转接光波导芯片

### 产品介绍

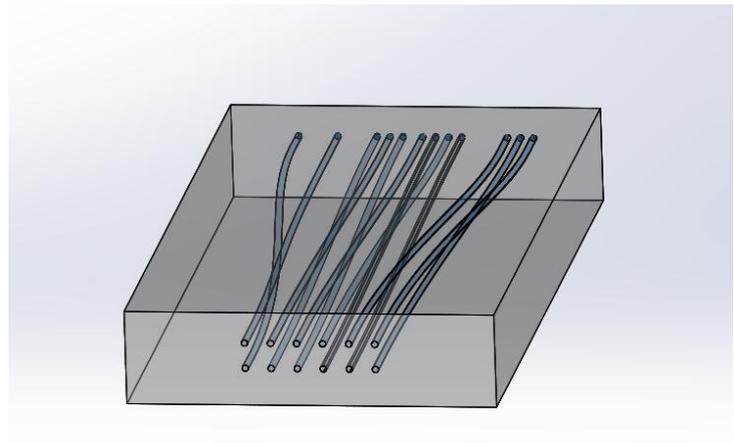
PIC 扇出转接光波导芯片基于深光谷自主研发的飞秒激光直写技术，能够匹配自研 PIC、主流 PIC，定制 FA、MT 插芯、MCF 等芯片、器件端面光口排布，实现任意三维形状结构的加工制备，为光芯片的光路扇入扇出需求提供可能。通过飞秒激光直写技术，可以在玻璃基板上制备出具有低传输损耗和圆形截面、高对称模场的小型化、低损耗三维光波导芯片，这对于实现高密度光互连产品具有重要意义。

### 主要特征

- 基于先进的 3D 激光直写技术
- 从 VIS 到 NIR 都有较高的光学透过率
- 可定制化的模场直径
- 较低的介电损耗，适用于 20GHz+
- 兼容 TGV 通孔技术、硅光工艺平台
- 高尺寸稳定性、热稳定性和化学稳定性
- 低传输损耗和耦合损耗
- 圆形截面、大小可控、兼容高阶模式

### 应用领域

- 高密度光通信、光互连
- 3D 光电集成，微纳光学器件
- 光学传感、光计算
- 量子计算、量子信息处理



### 产品参数：

参数项目	最小	典型值	最大	备注
工作波长(nm)	380nm	1310nm	2400nm	
端到端损耗 (dB)		0.7dB		
回波损耗 (dB)		-50dB		

偏振相关损耗 PDL(dB)	0.05dB		0.1dB	
模场直径 (μm)	5μm	9μm	25μm	
芯间串扰(dB)		-50dB		
写入深度 (μm)	50μm		400μm	
波导芯片尺寸 (mm)	支持通道数、Pitch、位置定制化			
扇出端面	支持匹配 FA、MT 插芯、MCF 等多场景、多排波导定制化			

### 订购信息:

订购信息	玻璃材料	备注
任意三维波导结构	Corning EAGLE XG Glass、Schott BOROFLOAT 33、各类无碱高硼玻璃、磷酸盐玻璃、光敏玻璃、晶体材料等	小弯曲半径的波导器件需提前弯曲损耗标定； 可定制化加工多排多列空间波导映射

### 七芯波导芯片 示意图:

